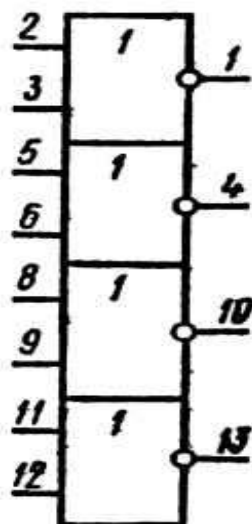


КР1533ЛЕ1, КФ1533ЛЕ1, ЭКА1533ЛЕ1, ЭКФ1533ЛЕ1

Микросхемы представляют собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1 - выход $\overline{D1}$; 2 - вход D1.1; 3 - вход D1.2; 4 - выход $\overline{D2}$; 5 - вход D2.1; 6 - вход D2.2; 7 - общий; 8 - вход D3.1; 9 - вход D3.2; 10 - выход $\overline{D3}$; 11 - вход D4.1; 12 - вход D4.2; 13 - выход $\overline{D4}$; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛЕ1, КФ1533ЛЕ1, ЭКА1533ЛЕ1, ЭКФ1533ЛЕ1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня:	
при $I_{\text{вых}}^0 = 4$ мА	≤ 0,4 В
при $I_{\text{вых}}^0 = 8$ мА	≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,5 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ -1,5 В
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения при $U_{\text{п}} = 5,5$ В	≤ 4 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при $U_{\text{п}} = 5,5$ В	≤ 2,2 мА
Входной ток низкого уровня	≤ -0,1 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Входной пробивной ток	≤ 0,1 мА
Выходной ток	-30 ... -112 мА
Время задержки распространения сигнала при включении	≤ 10 нс

Время задержки распространения сигнала
при выключении ≤ 12 нс
Емкость входа ≤ 4 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальный выходной ток низкого уровня 8 мА
Максимальный выходной ток высокого уровня | -0,4 | мА
Напряжение питания 4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня 0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня 2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход 5,5 В
Температура окружающей среды -10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов

производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.